

台灣發明商品促進協會 函

地址：台北市松山區八德路二段400號7樓
承辦人：賴淑玲
電話：02-8772-3898
電子信箱：wiipa168@wiipa.org.tw

受文者：東吳大學

發文日期：中華民國114年12月30日
發文字號：台發協字第1140123002號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：(文稿1_0123002A00_ATTCH1.docx、文稿1_0123002A00_ATTCH2.pdf)

主旨：敬邀貴校師生參加「2026 日本大阪設計創意暨發明展」，並說明原「2026 日本東京設計創意暨發明展」活動異動事宜，請查照。

說明：

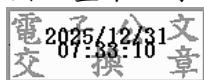
- 一、茲因 2026 年日本東京設計創意暨發明展主辦單位所使用之原訂場地，因配合定期更新及施工需求，原規劃於 2026 年 7 月 4 日至 7 月 5 日 假 東京 Bellesalle Haneda Airport Hall 舉辦之發明展覽活動，爰調整辦理地點與日期，改於 2026 年 7 月 3 日至 7 月 4 日 假 大阪 Kansai Airport Conference Halls 舉行，特此說明。如因此造成不便，尚祈 見諒。
- 二、2026日本大阪設計創意暨發明展將於115年7月3日~7月4日在大阪舉行，這是青年發明家和新銳設計師，促進國際交流與商業合作的最佳平台，敬邀 貴校師生參賽，請惠予公告並鼓勵相關人員踴躍參加。
- 三、即日起報名至115年5月28日止，洽詢專線(02)8772-3898分機19賴小姐或email至wiipa168@wiipa.org.tw。

東吳大學



正本：國立臺灣海洋大學、國立臺灣大學、國立臺灣大學計算機及資訊網路中心、國立臺灣大學生物資源暨農學院附設山地實驗農場、國立臺灣大學生物資源暨農學院附設農業試驗場、國立臺灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院、國立臺灣師範大學、國立陽明交通大學、國立臺北藝術大學、國立臺北教育大學、臺北市立大學、東吳大學、中國文化大學、世新大學、銘傳大學、實踐大學、大同大學、臺北醫學大學、康寧學校財團法人康寧大學、國立臺灣戲曲學院、國立臺北護理健康大學、國立臺北商業大學、國立臺北大學、國立臺灣藝術大學、馬偕學校財團法人馬偕醫學院、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、淡江大學學校財團法人淡江大學、華梵大學、真理大學、國立體育大學、國立中央大學、中原大學、長庚大學、元智大學、開南大學、國立清華大學、玄奘大學、中華大學學校財團法人中華大學、國立聯合大學、國立臺中教育大學、國立臺灣體育運動大學、國立中興大學、國立中興大學計算機及資訊網路中心、東海大學、逢甲大學、靜宜大學、中山醫學大學、亞洲大學、國立彰化師範大學、大葉大學、明道學校財團法人明道大學、建國科技大學、國立暨南國際大學、國立嘉義大學、國立中正大學、南華大學、國立臺南藝術大學、國立臺南大學、台灣首府學校財團法人台灣首府大學、中信學校財團法人中信金融管理學院、長榮大學、國立中山大學、國立高雄師範大學、國立高雄大學、義守大學、高雄醫學大學、國立屏東大學、國立金門大學、國立宜蘭大學、佛光大學、國立東華大學、慈濟學校財團法人慈濟大學、國立臺東大學、國立空中大學、高雄市立空中大學

副本：



施養晨 會長